

高電流密度対応ビアフィリング用硫酸銅めっき添加剤

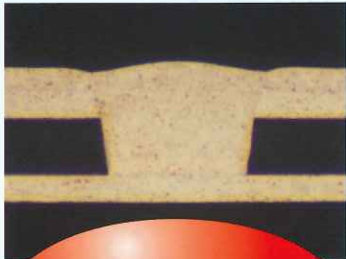
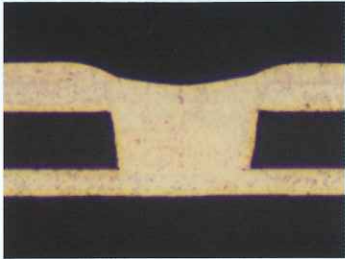
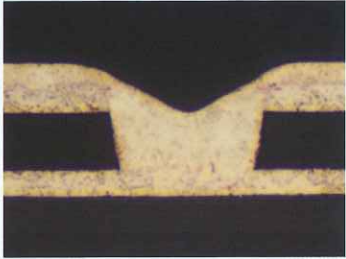
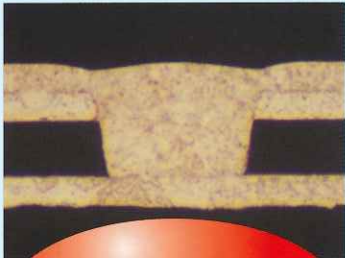
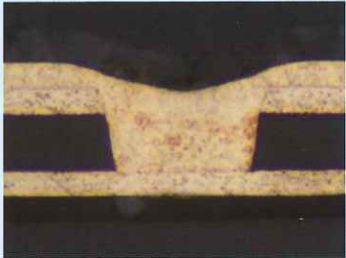
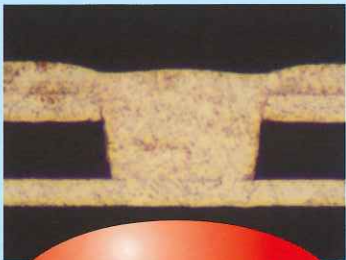
Acid Copper Plating Additives for Via-filling Applicable to High Current Density

トップルチナHV

TOP LUCINA HV

- 優れたビアフィリング性能を発揮
 - 幅広い電流密度 (1.0~10A/dm²) に対応可能
 - 全ての添加剤成分の定量分析が可能
 - 2液構成のため、浴管理が簡便
- Excellent performances to fill via-holes
 - Applicable to wide current density (1.0 to 10A/dm²)
 - Quantitative analyses are available for all additives
 - Easy bath control since consisting of two solutions

電流密度
Current density

		6A/dm ²	8A/dm ²	10A/dm ²
めっき膜厚 Plating thickness	10μm	 ビアフィリング達成 Great filling property		
	12μm		 ビアフィリング達成 Great filling property	
	14μm			 ビアフィリング達成 Great filling property

硫酸銅五水和物 220 g/L, 硫酸 80 g/L, 塩化物イオン 50 mg/L
H₂SO₄·5H₂O H₂SO₄ Cl⁻

穴径 75 μm, ビア深さ 50 μm
Via diameter Via depth